

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于合肥晶合集成电路股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对晶合集成部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2023 年 5 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成首次公开发行股票科创板上市公告书》。

### 二、募投项目的基本情况

根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：亿元

序号	项目名称	拟使用募集资金额
1	合肥晶合集成电路先进工艺研发项目	49.00
1.1	后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含90纳米及55纳米）	6.00
1.2	微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）	3.50
1.3	40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	15.00
1.4	28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目	24.50
2	收购制造基地厂房及厂务设施	31.00
3	补充流动资金及偿还贷款	15.00
合计		95.00

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

### 三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“收购制造基地厂房及厂务设施”，上述募投项目已于2023年9月收购完成并取得相关产权证书。截至2023年12月15日，募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额A	累计已投入募集资金金额B	利息收入及现金产品管理收益扣除手续费后净额C	募集资金账户节余资金总金额D=A-B+C
收购制造基地厂房及厂务设施	310,000.00	276,393.67	608.54	34,214.87

注：“募集资金账户节余资金总金额”不包含截至2023年12月15日尚未收到的银行利息收入及现金产品管理收益，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准；上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

### 四、募集资金节余的主要原因

1、在募投项目收购过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在确保质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控收购环节和付款进度，合理降低项目相关成本和费用。

2、2021年8月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更上市募投项目的议案》，公司拟使用31亿元募集资金用于收购制造基地厂房及厂务设施，拟收购资产的评估值为32.2亿元。考虑到间隔时间较长、资产成新率降低的因素，公司和合肥蓝科投资有限公司（以下简称“合肥蓝科”）共同委托安徽中联合国信资产评估有限责任公司，以2023年4月30日为评估基准日出具了《拟转让资产涉及的固定资产及土地使用权评估项目资产评估报告》（皖中联合国信评报字（2023）第189号），对合肥蓝科拟转让的资产市场价值进行重新评估，不含税资产评估值为27.05亿元。最终基于评估价确定合同价款为含税27.64亿元，截至目前，该募投项目已收购完成并取得相关产权证书，形成了募集资金节余。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

## 五、节余募集资金的使用计划

鉴于上述募投项目已收购完成并取得相关产权证书，为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，公司拟将募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”的节余资金34,214.87万元（截至2023年12月15日，含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

该募投项目资金存储于以下两个募集资金专户：

序号	开户主体	开户行	银行账号
1	晶合集成	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618
2	晶合集成	中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609

待节余募集资金转出后，上述在中国工商银行合肥四牌楼支行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。在中国建设银行合肥龙门支行开立的

募集资金专户由于涉及“收购制造基地厂房及厂务设施”项目外其他募集资金存储，公司仍将保留该募集资金专户，继续用于其余募集资金存储及使用。

## 六、履行的审议程序及专项意见

2023年12月22日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会发表意见“公司募投项目‘收购制造基地厂房及厂务设施’已收购完成并取得相关产权证书，同意将该项目予以结项。公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。”

公司独立董事发表意见“公司募投项目‘收购制造基地厂房及厂务设施’结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于进一步提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东，特别是中小股东合法利益的情形。综上所述，我们一致同意公司“收购制造基地厂房及厂务设施”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。”

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过并发表明确同意意见，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



周 玉



李义刚

中国国际金融股份有限公司



2023年12月25日

1101030073370